

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

河北中瓷电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

2025-004 号

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（“共鉴科技未来，共绘产融新程，共筑电科价值”2025年中国电科产融大会暨控股上市公司投资者交流活动）
参与单位名称及人员姓名	参与 2025 年中国电科产融大会暨控股上市公司投资者交流活动的投资者
时间	2025 年 9 月 18 日（周四）
地点	北京西南华邑酒店
上市公司接待人员姓名	1、董事长 卜爱民 2、常务副总经理（代总经理） 梁向阳 3、财务总监、副总经理、董事会秘书 董惠
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 一、整体阐述公司在第三代半导体和电子陶瓷行业发展的情况及公司当前业务基本情况未来布局以及如何把握作为新质生产力的发展机遇。 回复：（一）公司各领域行业发展情况： 公司是国内电子陶瓷领域能与国际知名企业进行竞争的少数厂商之一，是我国电子陶瓷外壳的主要代表企业，在国内电子陶瓷行业具有重要影响力。作为电子陶瓷行业的先行者，公司积极参与品牌经营，树立了企业良好的市场形象，陆续与多家世界知名光通信生产厂家建立了良好的合作关系。在电子陶瓷（外壳）市场份额居国内行业前列（逐步向结构陶瓷和陶瓷元件拓展），致力于发展成为世界一流的电子陶瓷产品供应商。

依托国内领先的研发及产业化平台，公司氮化镓通信基站射频芯片与器件产品技术指标及产品可靠性达到国内领先、国际先进水平，作为国内领先的氮化镓通信基站射频芯片与器件、微波点对点通信射频芯片与器件供应商，公司在细分领域市场占有率国内第一，产品技术与质量均达到国内领先、国际先进水平，与客户深入合作，行业知名度较高，在业内树立了企业良好的品牌形象，品牌知名度和信誉度得到用户的高度认可。

碳化硅功率模块及其应用领域实现了碳化硅电力电子和氮化镓射频电子产品的自主研发、设计生产的能力，其中氮化镓射频功放芯片技术水平达到国际领先，并已在世界主流通信公司得到规模应用；碳化硅 MOSFET 技术水平达到国内领先，并已在新能源汽车、充电桩等领域开始大批量应用。

（二）未来布局及新质生产力方面的发展机遇：

电子陶瓷领域，紧抓全球新一轮 AI 技术爆发带动算力需求激增，算力增长带来的市场机遇，继续扩大光通信产品的优势，同时针对消费电子市场，快速扩产，扩大国内市场占有率并出海。针对半导体设备市场，全面开发陶瓷零部件产品，实现跨越式发展。完成电子陶瓷外壳生产线建设项目建设，增强陶瓷外壳的生产能力。针对消费电子市场的逐步回暖，重点开发声表、晶振类产品，实现重点客户的批量交付。

第三代半导体氮化镓通信基站射频芯片与器件领域，紧密围绕战略目标，坚持“市场牵引、科技驱动”，在保持现有优势的基础上，进一步提升市场占有率，保障公司持续、健康、稳定发展。围绕 5G-A、6G、卫星通信及电力电子新能源等系统应用需求，开展新技术攻关，推动产业化应用，保持企业技术竞争力。

第三代半导体碳化硅功率模块及其应用领域，通过紧跟市场前沿，拓展新产品需求，时刻紧跟技术发展节奏，按照“领先生产一代、储备一代、开发一代”的技术路线，保证产品快速升级换代，同时加快第三代半导体工艺及封测平台建设，形成系列产品，实现氮化镓、碳化硅双引擎发展，同时延伸公司产品链，完

成公司既定目标。

二、中瓷在电科集团整体战略定位，以及十五五期间在业务和科技创新的布局。

回复：中瓷电子在电科集团隶属于做强基础板块，属于制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业。十五五期间在业务和科技创新的布局：

（一）面向低空经济：

1、重点进行无人机等低空飞行器用的封装市场开拓(射频功率管/红外探测器/MEMS 传感器/电力电子模块等封装)。

2、针对新一代 5G-A 通感一体基站，持续进行氮化镓功放技术突破和产品创新。

3、开拓氮化镓射频器件在无人机道控/图传等应用领域的新市场。

4、针对无人机动力系统、重点研发 SiC 电力电子芯片及模块。

（二）面向汽车电子：

1、重点进行面向新能源乘用车用加热器、陶瓷压力用传感器封装等产品的开发和市场开拓。

2、加快 SiC 8 英寸工艺线产品的客户导入；OBC 拓展至更多车企用户，开发新型更高性价比产品。针对特定车企进行攻关，实现主驱应用突破。

（三）面向大数据 AI：

1、利用技术规模优势，针对面向数据中心 800G、1.6T 光模块用基板，深入拓展市场，提升新质能力和市场占有率。

2、针对 AI 服务器供电系统向 800V 直流转变的趋势，面向高压应用，积极布局 1200V/1700V/3300V 工作电压等 SiC MOS 芯片和模块的研发。

（四）针对出海：

1、通过参加展会等有效途径，积极拓展国际市场, 产品出海；

2、借助合作伙伴的成熟网络，推动技术出口海外；

3、积极推进海外建厂，运营出海。

	<p style="text-align: center;">三、阐释在市值管理方面的理解和具体措施？</p> <p>回复：对市值管理的理解：市值管理是上市公司基于公司内在价值，通过价值创造、价值实现与价值传播的有效管理，实现公司价值最大化与股东利益最大化的战略管理行为。总结来说就是“内强质地，外塑形象”。</p> <p>1. “内强质地”就是通过技术研发、治理等维度的实力提升，构建不可替代的核心竞争力，为市值提供长期稳定的支撑。</p> <p>（1）公司聚焦技术创新，强化价值创造能力，抓住 AI 算力、商业航天、低空经济、新能源汽车等新质生产力发展的机遇，持续推动氮化镓/碳化硅和电子陶瓷领域的新材料/新工艺/新方法创新，打造根技术，开发根产品。（2）积极利用资本市场、谋划围绕产业链、核心科技的并购重组。</p> <p>2. “外塑形象”就是通过清晰的价值传递、透明的沟通机制、稳定的市场预期，让投资者正确认知企业内在价值。（1）全面提高公司信息披露质量，力争信息披露评级保持 A 级；（2）公司不断提高 ESG 专业治理能力，力争在资本市场发挥示范作用；（3）主动加强投资者关系管理，建立多层次良性互动，业绩说明会等投资者交流活动常态化召开；（4）制定合理可持续的利润分配政策，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性。</p> <p>“内强质地”与“外塑形象”两者协同发力，才能实现市值与企业内在价值的长期匹配最终达成市值管理目标。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025-9-18